

KOSDAQ | 반도체와반도체장비

오로스테크놀로지 (322310)

고객사·장비 다변화 시도 중

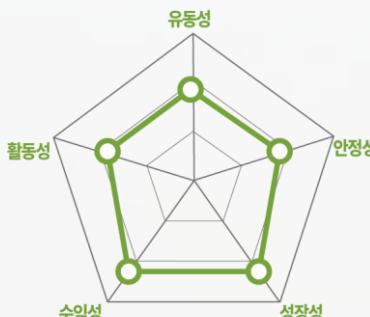
체크포인트

- 반도체 미세화 전환 지속에 따라 노광 공정 횟수 증가. 이는 Overlay 수요 확대 요인. 동사는 해외 고객사향 공급 확대 중으로 과거 대비 선단 공정 CAPEX 확대에 따른 수혜 강도가 강해질 것
- HBM향 IR Overlay, Pad Overlay, 박막 두께 측정 장비의 점진적인 시장 확대를 기대. 특히 박막 두께 측정 장비는 Overlay 장비와 같이 전 공정에서 수요가 큰 장비로 동사 시장 진입 시 국산화와 전공정 장비 라인업 확대의 의미가 큼
- 2025년 연간 실적은 매출액 787억 원(+28.1% YoY), 영업이익 103억 원(+69.1% YoY)을 전망. 하반기로 갈수록 고객사 CAPEX 확대와 제품 포트폴리오 다변화로 실적 개선 기대

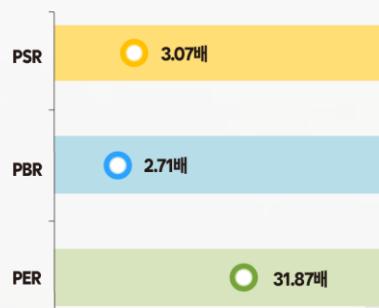
주가 및 주요이벤트



재무지표



밸류에이션 지표



오로스테크놀로지 (322310)

KOSDAQ

Analyst 박성순 sspark@kirs.or.kr

RA 김혜빈 hbkим@kirs.or.kr

반도체와반도체장비

반도체 계측 장비 업체

오로스테크놀로지는 2009년 설립되어 2021년 코스닥 시장에 상장한 반도체 계측 장비 업체. Overlay 계측 장비가 가장 큰 매출 비중을 차지. 2024년 기준 매출 비중은 OL-12inch 68.1%, 기타 제품 21.7%, 용역 7.7%, 상품 2.5%를 기록

미세화 수혜와 장비 다변화

반도체 미세화 전환 지속에 따라 Overlay 장비 수요 확대가 기대. Overlay는 노광 공정 횟수 증가에 따라 수요가 함께 증가. 또한 국내 고객사 중심에서 해외 고객사로 공급이 다변화 중. Overlay 장비의 영역을 기준 전공정에서 후공정으로 확대할 계획. HBM향 IR Overlay, Pad Overlay와 박막 두께 측정 장비의 점진적인 시장 확대를 기대. 장비 다변화로 실적 변동성 축소 예상

고객사 및 장비 다변화로 고객사 CAPEX 성장을 상회하는 실적 기대

2025년 연간 실적은 매출액 787억 원(+28.1% YoY), 영업이익 103억 원(+69.1% YoY)을 전망. 상반기는 계절적 비수기 영향으로 다소 저조하나, 하반기로 갈수록 고객사 CAPEX 확대와 제품 포트폴리오 다변화로 실적이 개선될 것으로 기대. 제품 믹스 다변화 초기 비용으로 이익 변동성이 커질 가능성이 있으나, 하반기 해외 출하와 선단 공정 장비 확대를 통해 매출과 수익성 성장세가 지속될 전망

Forecast earnings & Valuation

	2021	2022	2023	2024	2025F
매출액(억원)	395	354	455	614	787
YoY(%)	125.4	-105	286	34.9	28.1
영업이익(억원)	19	-33	24	61	103
OP 마진(%)	4.9	-9.3	5.2	9.9	13.1
지배주주순이익(억원)	18	-30	34	59	92
EPS(원)	198	-318	361	631	977
YoY(%)	28.7	적전	흑전	74.8	54.9
PER(배)	158.5	N/A	81.1	25.5	20.4
PSR(배)	7.2	3.5	6.0	2.5	2.4
EV/EBITDA(배)	68.5	N/A	45.7	14.6	10.2
PBR(배)	4.6	2.0	4.4	2.2	2.4
ROE(%)	4.2	-4.7	5.5	9.0	12.6
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

자료: 한국IR협의회 기업리서치센터

Company Data

현재주가 (7/18)	19950원
52주 최고가	26,450원
52주 최저가	13,400원
KOSDAQ (7/18)	820.67p
자본금	47억원
시가총액	1,869억원
액면가	500원
발행주식수	9백만주
일평균 거래량 (60일)	4만주
일평균 거래액 (60일)	8억원
외국인지분율	105%
주요주주	에프에스티 외 6인
	54.40%

Price & Relative Performance



Stock Data

주가수익률(%)	1개월	6개월	12개월
절대주가	-7.9	-9.5	-24.6
상대주가	-12.4	-20.1	-24.4

참고

1) 표지 재무지표에서 안정성 지표는 '부채비율', 성장성 지표는 'EPS 증가율', 수익성 지표는 'ROE', 활동성지표는 '총자산회전율', 유동성지표는 '유동비율'입니다. 2) 표지 베이스에이션 지표 차트는 해당 산업군내 동사의 상대적 베이스에이션 수준을 표시. 우측으로 갈수록 베이스에이션 매력도 높음.



기업 개요

1 오로스테크놀로지는 반도체 계측 장비 업체

오로스테크놀로지는 2009년

설립되어 2021년 코스닥 시장에

상장한 반도체 계측 장비 업체

오로스테크놀로지는 2009년 4월 설립된 반도체 오정렬(Overlay) 계측 장비 전문 기업이다. Overlay 계측은 반도체 제조 공정에서 회로 패턴이 다층으로 적층되는 과정에서 상·하부 패턴 간 정렬 상태를 나노미터 단위로 측정하는 기술로, 공정 미세화가 심화됨에 따라 핵심 계측 기술로 주목받고 있다. 설립 초기부터 Overlay 계측 장비의 국산화를 목표로 연구개발을 시작했으며, 2011년에는 국내 최초로 300mm Overlay 계측 장비 'OL-300n'의 양산에 성공했다. 해당 장비는 LED 광원을 최초로 적용해 램프 수명을 기존 대비 향상시켰고, 고해상도 패턴 이미지 구현이 가능하다.

이후 2013년 2세대 모델 'OL-600n', 2015년 3세대 'OL-700n', 2018년 4세대 'OL-800n', 2020년에는 5세대 장비 'OL-900n', 2024년 6세대 'OL-1000n'을 연이어 출시했다. 2017년에는 SK하이닉스로부터 기술혁신기업에 선정되며 기술력을 인정받았고, 2021년 2월 코스닥에 상장하였다. 이후 미국(텍사스)과 중국(우시)에 현지 법인을 설립하였고, 2023년에는 중국 상하이 사무소도 추가로 개소하며 글로벌 진출 기반을 마련했다. 또한, 국내에서는 2022년 연세대학교와 공동으로 첨단 나노계측 연구센터를 설립하고, 2023년 동탄 제2사업장 R&D센터 개설 및 화성 본사 공장을 확장하며 생산 및 연구 인프라를 강화했다. 2024년에는 12인치 패키지 오버레이 장비 'HE-900PAD', 300mm 적외선 기반 장비 'HE-900ir' 등을 출시하며 최신 패키징 및 미세공정 대응 역량을 강화했고, SEMICON Korea, China, Taiwan, Japan 등 글로벌 전시회에 참가하며 해외 고객 확대를 위한 마케팅을 강화하고 있다.

오로스테크놀로지 연혁

2009~2012	2013~2019	2020~
<p>2009.03 주식회사 프로티스 설립</p> <p>2009.04 주식회사 오로스로 상호 변경</p> <p>2009.07 오로스 R&D 센터 설립 오버레이 측정장비 사업 시작</p> <p>2010.04 [주]제이엔씨와 핵협약 주식회사 '오로스테크놀로지'로 상호 변경</p> <p>2011.02 SEC, SK 하이닉스와 2011반도체 장비 겸용 프로그램 수행</p> <p>2011.04 1세대 300mm(12) 오버레이 계측장비(OL-300n) 출시</p> <p>2012.02 종합반도체업체 고객으로부터 대량생산 수행 평가 인증 획득</p> <p>2012.08 본사 이전(경기도 화성시 삼성로 5길 25(석우동))</p> <p>2012.09 오버레이 측정장비 중국 진출 중국 우시 CS 사무소 설립 오버레이 계측장비 중국 진출</p> <p>2012.10 제 42회 한국정밀기전대회 지식경제부 장관상 수상</p> <p>2012. 제 5회 반도체의 날 수상</p> <p>2012.12 오버레이 계측기 기세이세이일류상품 선정</p>	<p>2013.07 2세대 300mm(12) 오버레이 계측기(OL-600n) 출시</p> <p>2013.08 과학기술정보통신부 R&D 경영실상 수상</p> <p>2013.09 이천 CS 사무소 설립</p> <p>2013.12 종소사 입찰 수출유망중소기업 선정</p> <p>2014.02 경기도테크노파크 IP스터기업 선정</p> <p>2014.09 특허청 직무발명보상 우수기업 선정</p> <p>2015.04 일본 등록 영업소 설립</p> <p>2015.07 3세대 오버레이 측정장비(OL-700n) 출시</p> <p>2016.03 본사 이전(경기도 화성시 동탄산단 6길 15-23)</p> <p>2016.11 ISO9001/14001 및 OHSAS18001 인증서 획득</p> <p>2017.03 SK하이닉스 기술혁신기업 선정</p> <p>2018.0 1세대 웨이퍼 오버레이 측정장비(OL-100n) 출시</p> <p>2018.07 4세대 오버레이 측정장비(OL-800n) 출시</p> <p>2019.10 제 12회 반도체의 날 오로스테크놀로지 국무총리 표창 수상</p> <p>2019.011 반도체 오버레이 계측기 세계일류상품 선정</p>	<p>2020.04 소재부품장비 전문기업 선정(산업통상자원부)</p> <p>2020.08 판교 R&D센터 개설</p> <p>2020.09 기술상 평가등급 A 획득(한국전자통신연구원(ETRI))</p> <p>2020.10 소재부품정책 강소기업 100 선정</p> <p>2020.12 5세대 오버레이 측정장비(OL-900n) 출시</p> <p>2021.02 코스닥 시장 상장</p> <p>2021.05 동탄 연구소(Thin Film) 토지 및 건물 취득</p> <p>2021.07 AUROSTECH USA, Inc. 미국법인 설립 Auro Tech (Wuxi) Co., Ltd. 중국법인 설립</p> <p>2021.10 1세대 300mm(12) 패키지 검사기(WoPS-30) 출시</p> <p>2021.12 동탄 제2사업장 설립</p> <p>2022.05 글로벌 IP스터기업 지정</p> <p>2022.12 [연세대와 함께] 나노계측 연구센터 설립 평택 고덕 CS 사무소 설립</p> <p>2023.01 화성 석우동 fabrication facility 설립</p> <p>2023.03 동탄 제2사업장 R&D센터 설립</p> <p>2023.10 6세대 300mm(12) 오버레이 계측기(OL-1000n) 출시</p> <p>2024.07 일본 도쿄 지점 설립</p> <p>2024.08 중국 우시 생산법인 설립</p>

자료: 오로스테크놀로지, 한국IR협의회 기업리서치센터

▣ 종속회사 현황

2025년 1분기말 기준 연결대상

종속회사는 미국 1개사, 중국

2개사로 총 비상장 3개사 보유

2025년 1분기말 기준, 오로스테크놀로지는 연결대상 종속기업으로 미국 Auros Technology USA, Inc.(지분율 100.0%), 중국 2개사 Auros Tech (Wuxi) Co., Ltd.(지분율 100.0%), 无锡傲世半導體技術有限公司(지분율 100.0%) 총 3개의 비상장사를 보유하고 있다. AUROS Technology USA, Inc.(지분율 100.0%)은 미국 현지 개발활동을 위해 2021년 7월 설립하였으며, 2025년 1분기말 별도 기준 총자산은 97백만 원, 당기순손실은 65백만 원이다. 같은 달, 중국 영업을 위해 설립된 Auros Tech (Wuxi) Co., Ltd.(지분율 100.0%)의 2025년 1분기말 별도 기준 총자산과 당기순손실은 30억 원, 4억 원이다. 이후, 2024년 중국 내 사업 확장을 위해 설립된 종속법인 无锡傲世半導體技術有限公司(지분율 100.0%)의 2025년 1분기말 별도 기준 총자산과 당기순손실은 각각 27억 원, 39백만 원이다.

오로스테크놀로지 지분도



▣ 주요 사업 및 매출 구성

2024년 기준 매출 비중은

OL-12inch 68.1%, 기타 제품

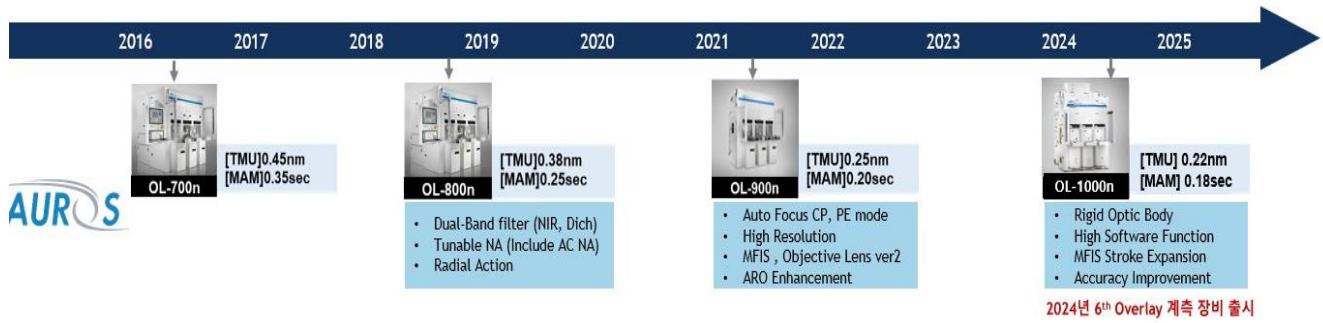
21.7%, 용역 7.7%, 상품 2.5%

동사의 주요 사업은 반도체 MI(Metrology, Inspection) 장비 제조업으로, 특히 Overlay 계측 장비가 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있다. 2024년 기준 매출 비중은 OL-12inch 68.1%, 기타 제품 21.7%, 용역 7.7%, 상품 2.5%를 기록하였다.

Overlay 계측 장비

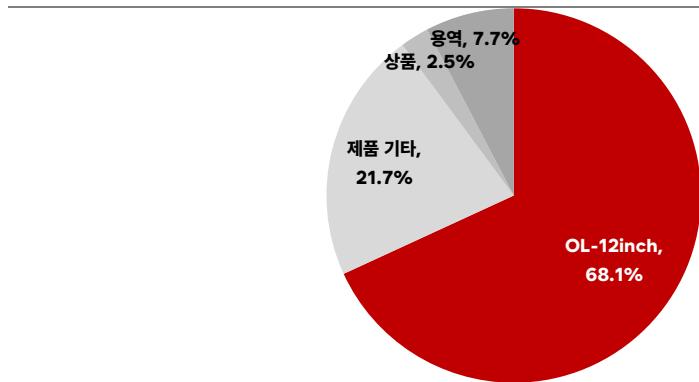
반도체 제조 과정에서 회로패턴이 다층 적층되는 공정에서 하부 패턴과 상부 패턴 간의 정렬상태를 나노미터 단위로 정밀 계측하는 장비이다. Overlay는 노광장비로 빛을 쪼여주는 공정을 진행한 이후 정상적인 위치에 쌓였는지 검사하는 작업으로, 이전 공정에서 제작된 회로패턴과 현재 공정에서 제작된 회로패턴 간의 수직방향 정렬도(혹은 오정렬) 및 정렬도의 제어(Overlay Control)를 의미한다. 노광장비로 패턴을 한 층 쌓을 때마다 Overlay 계측을 통해 나노 단위 오차를 확인하고 노광기 위치를 보정한다. 현재 글로벌 시장에서는 미국의 KLA Corporation이 시장의 약 70%를 차지하는 주요 업체이다.

오로스테크놀로지 Overlay 장비



자료: 오로스테크놀로지, 한국IR협의회 기업리서치센터

오로스테크놀로지 매출 비중



주: 2024년 기준, 자료: 오로스테크놀로지, 한국IR협의회 기업리서치센터

▣ 주주 구성

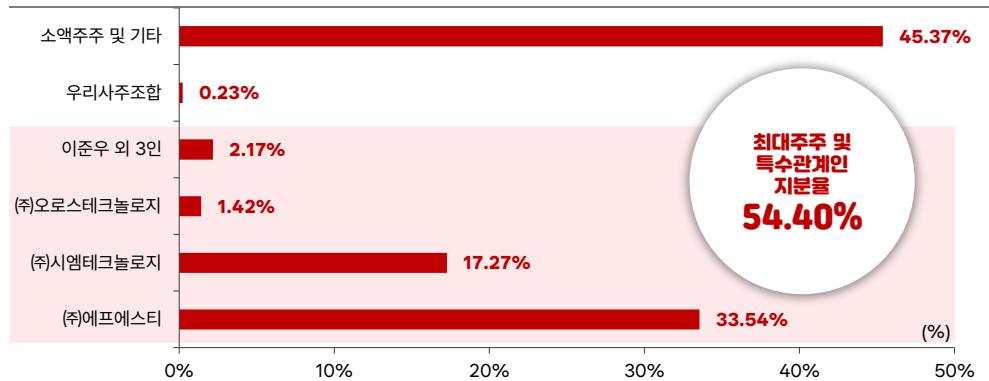
2025년 1분기말 기준

최대주주는 (주)에프에스티로

지분율 33.54% 보유

오로스테크놀로지의 최대주주는 (주)에프에스티로, 지분 33.54%를 보유하고 있다. (주)에프에스티는 1987년 9월에 설립되어 2000년 1월에 코스닥 상장하였으며, 반도체/디스플레이 펠리클(노광 및 식각 공정에서 사용되는 포토마스크를 이물질로부터 보호하기 위해 사용되는 소재) 및 칠러(반도체 공정에서 과도한 열의 발생이 일어나는 챔버 내 웨이퍼나 주변온도를 일정하게 유지함으로써 공정효율을 개선하는 장비) 등을 공급하고 있다. (주)에프에스티의 2024년말 연결 기준 자산총계는 5,061억 원이며, 2024년 매출액과 영업이익은 각각 2,374억 원, 23억 원을 기록했다.

오로스테크놀로지 주주 현황




산업 현황
1 **Metrology & Inspection 시장 개요**

**글로벌 반도체 MI 시장은
연평균 5.2%로 성장해 2030년
141.9억 달러까지 증가할 전망**

글로벌 반도체 Metrology & Inspection(MI)시장은 2025년 약 110억 달러로 추정되며 2030년까지 141.9억 달러로 성장할 것으로 전망된다(CAGR 5.2%). 이 중 Metrology(계측) 시장은 2025년 약 80억 달러로 추정되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 8%로 성장해 약 133억 달러에 이를 것으로 전망된다.

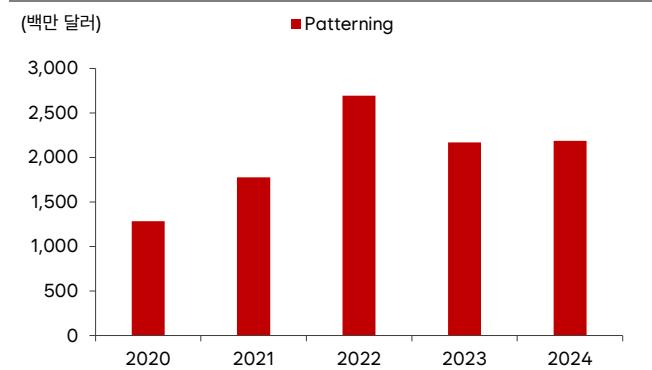
**반도체 제조 공정에서
Metrology는 물리적/전기적
특성 측정, Inspection은 결함
탐지**

Metrology는 반도체 제조 공정에서 차수, 두께, 구성 요소 등의 물리적 및 전기적 특성을 측정하는 과정으로, 임계 차수(CD-SEM), 박막 두께, 오버레이 정렬 등을 측정한다. Inspection은 웨이퍼 표면의 입자, 패턴 결함, 기타 성능에 영향을 미칠 수 있는 조건을 탐지하는 과정이다. 두 과정은 모두 품질 관리에 필수적이지만, Metrology는 측정과 특성화에, Inspection은 결함 탐지에 특화되어 있다.

**KLA는 글로벌 Metrology &
Inspection 시장 내 점유율 1위
차지**

KLA Corporation(미국)은 Metrology 및 Inspection 시장 선두 업체로 글로벌 시장 점유율 약 55~58%의 1위 업체이다. 2025년 기준 KLA 내 MI 매출 비중은 Inspection 47%, Metrology 20%로 전체 매출액의 67%를 차지한다. 이외 주요 기업으로 Applied Materials(미국), ASML(네덜란드), Onto Innovation(미국), Thermo Fisher Scientific(미국), Hitachi Hi-Technologies(일본)가 있으며 각각 박막 측정, 첨단 패키징, 재료 특성화, 검사 시스템 등에서 강점을 보인다.

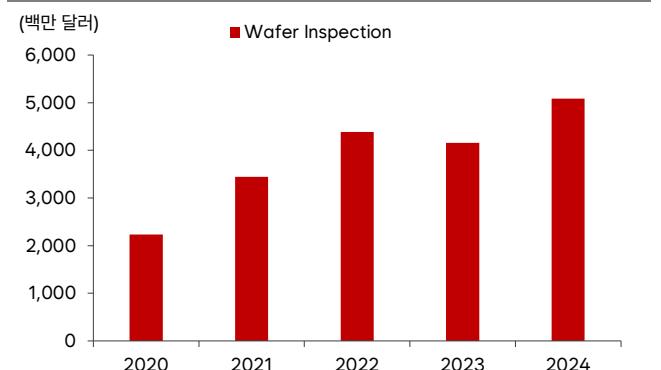
KLA Patterning 매출액 추이



주: Patterning 사업부는 Metrology(계측) 관련 매출을 포함

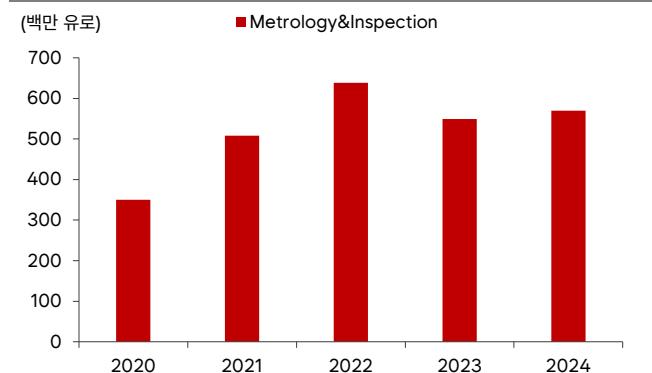
자료: KLA, 한국IR협의회 기업리서치센터

KLA Inspection 매출액 추이



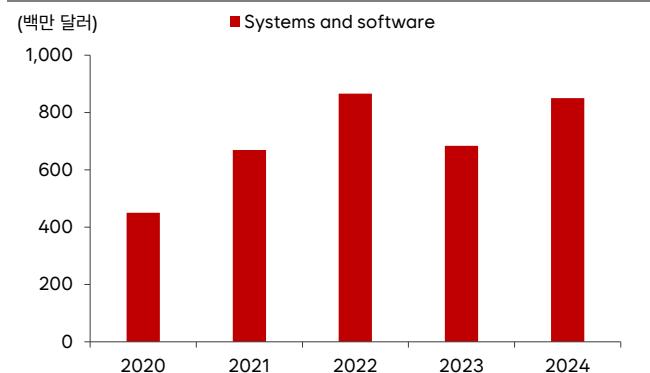
자료: KLA, 한국IR협의회 기업리서치센터

ASML MI 매출액 추이



자료: ASML, 한국IR협의회 기업리서치센터

Onto Innovation System & Software 매출액 추이



자료: Onto Innovation, 한국IR협의회 기업리서치센터

▣ 반도체 공정 나이도 증가로 Metrology 수요 확대

반도체 미세화/고단화 및 Capex

증가 등에 따른 Metrology 수요

확대 전망

Metrology 시장 수요는 반도체의 미세화 및 고집적화, 첨단 패키징 및 3D 구조, 공정 복잡성 증가, 반도체 CAPEX 증가 등에 인해 견인된다. 5nm 이하 노드 및 3nm GAA(Gate-All-Around) 공정 등은 트랜지스터 밀도를 극대화하고 성능을 향상시키는 과정에서 나노미터 수준의 정밀한 측정과 제어를 필수적으로 요구한다. 이에 따라 임계 치수, 박막 두께, 오버레이 정렬 정밀도 등을 정확히 측정하는 Metrology 장비의 중요성이 부각되고 있으며, 반도체 공정이 고도화될수록 Metrology의 수요도 지속적으로 확대될 것으로 전망된다.

또한, 첨단 패키징 및 3D 구조에 대한 정밀한 측정 요구도 증가하고 있다. 3D NAND, HBM, 팬아웃 패키징(Fan-out Packaging) 등은 다층 웨이퍼 스태킹과 이중 칩 통합을 통해 AI, 데이터센터, 자동차 전자제품 등 고성능 수요를 총족시키는데, 이 때 각 층 간의 오버레이 정밀도와 물성 특성 측정이 필수적이다. 즉, TSMC의 CoWoS¹ 공정 확대와 SK 하이닉스의 HBM 생산량 증가는 다층 오버레이 측정 수요를 가속화하며, 이는 OSAT 및 파운드리 시장 전반에서 Metrology 장비에 대한 수요로 이어진다.

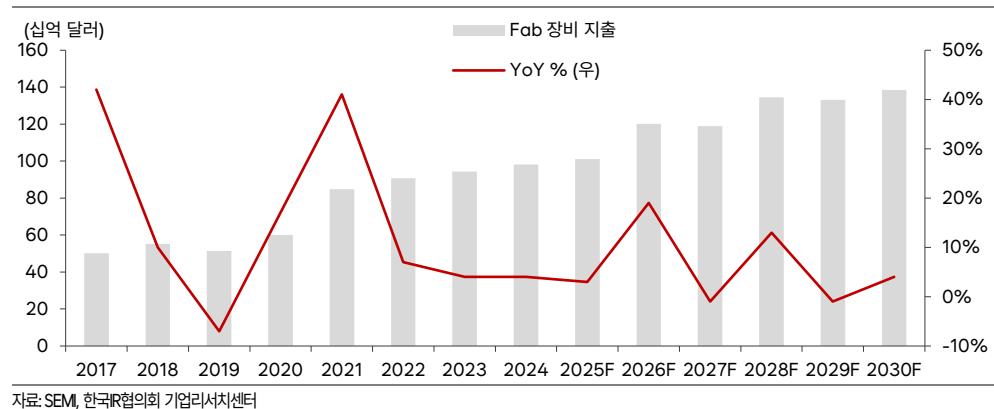
이처럼 공정 복잡성 심화로 결함 발생 가능성이 높아짐에 따라, 정밀 측정을 수행하는 Metrology 장비의 역할이 더욱 중요해지고 있다. 반도체 제조는 약 400~600단계에 이르는 복잡한 공정을 거치며, 특히 EUV 리소그래피와 같은 첨단 기술 도입으로 결함 발생 가능성이 높아졌다. Metrology 장비는 각 공정 단계에서 치수, 두께, 오버레이 정렬 및 전기적 특성을 정밀하게 측정해 조기 결함을 탐지하고 수율을 향상시키며, 후속 공정 비용 절감과 제품 신뢰성 제고에 기여하는 역할을 한다.

또 다른 Metrology 수요 동인으로 CAPEX 증가(새로운 제조 시설의 건설과 기존 시설의 업그레이드)가 있다. Metrology 장비는 제조 라인에서 필수적인 품질 관리 도구로, 새로운 공정 도입이나 생산 용량 확대 시 필수적으로 구매된다. 글로벌 반도체 CAPEX는 2024년 981억 달러(+4% YoY)에서 2025년 1,010억 달러(+3% YoY) 증가할 것으로 예상되며 2030년까지 1,384억 달러로 확대될 전망이다. AI 데이터센터와 HPC 수요로 7nm 이하 첨단 공정 용

¹ CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)란 TSMC가 개발한 고대역폭 고성능 패키징 기술로, 2개 이상의 반도체 칩(Die)을 실리콘 인터포저 위 웨이퍼 수준에서 미리 연결한 뒤, 이를 패키지 기판에 탑재하는 방식

량은 2024년 85만장/월에서 2028년 140만장/월로 69% 성장(CAGR 14%)하며, 2nm 이하 용량은 2025년 20만장/월 미만에서 2028년 50만장/월 이상으로 급증할 전망이다.

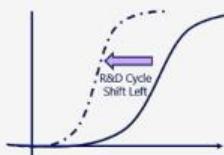
글로벌 반도체 CAPEX 추이



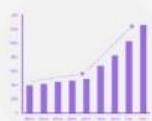
고도화되는 반도체 공정에서 반도체 계측의 도전 과제

Metrology Challenges

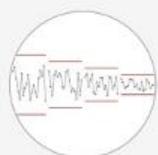
Process Complexity



Shorter R&D cycles
더 짧아지는 연구개발(R&D) 주기



More steps & higher sampling
공정 단계 및 샘플링(측정 빈도) 증가



Tighter specs as design rule shrinks
선팩 미세화로 허용 오차 범위 축소



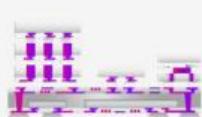
In-die & complex structures
복잡한 구조를 가진 계측 대상 증가



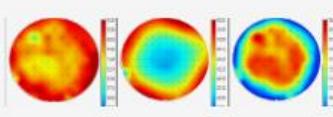
New materials & composition control
신소재 및 조성 제어 필요



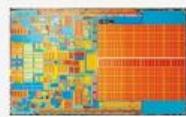
Chemical control to enable filling of HAR structures
고증횡비 구조를 균일하게 채우기 위한 화학적 공정 제어 요구



Topography & Profile 3D Packaging
3D 패키징에서 높이/형상 측정 필요



Local variation is critical: local density, Z Profiling
국부 변동성 중요: 국부 밀도 및 Z 프로파일링



Monitoring more parameters □ broader metrology scope
더 많은 파라미터 모니터링 → 확장되는 계측 범위

자료: SEMI Engineering, 한국IR협의회 기업리서치센터



1 반도체 미세화에 따른 노광 공정 증가는 Overlay 수요 확대 요인

반도체 첨단 공정 내

오차 허용 범위 축소와 노광 공정

횟수 증가로 Overlay 장비 수요

확대 전망

반도체 미세화 전환 지속에 따른 Overlay 장비 수요 확대가 기대된다. 노광 공정에서는 미세한 패턴의 사이즈를 정밀하게 형성하는 것뿐만 아니라, 공정 간 반복되는 패턴들이 정확히 정렬되도록 위치 정합(Overlay)을 유지해야 한다. 이를 위해 Alignment와 Overlay 두 공정이 필요하다. Alignment는 Alignment Mask를 인식해 노광을 하기 전 위치를 맞추는 공정이며, Overlay는 노광 진행 이후 패턴이 정상적으로 적층되었는지를 검사하는 공정이다. 두 공정 모두 Scribe line(웨이퍼 상 Die들을 한 개씩 자르기 위한 폭)에 있는 측정용 Mask를 이용해 회로 셀 위치의 어긋남을 파악한다. Overlay는 전수 검사가 아닌 일부 Wafer에 대해서만 결과 반영이 가능한 샘플 검사이다.

Overlay는 노광 공정 횟수 증가에 따라 수요가 함께 증가한다. 반도체 미세화는 트랜지스터와 회로 패턴 크기를 줄이는 과정으로서 단일 노광으로 구현할 수 있는 패턴의 한계가 발생한다. 이에 따라 한 층의 패턴을 여러 번에 걸쳐 나누어 형성하는 멀티 패터닝 공정이 활용되며, 이로 인해 필요한 마스크 레이어 수가 증가한다. 또한 트랜지스터 밀도를 높이기 위해 추가적인 마스크 공정도 요구된다. 예를 들면 Logic 28nm 공정에서는 약 50~60개의 마스크 레이어가 필요하지만, 5nm 공정에서는 120~130개로 증가한다. DRAM의 경우 1X nm 공정에서 약 50~55개, 1a nm에서 약 65~70개가 필요하며, 3D NAND는 64단 공정에서 약 180~200개, 176단에서 300개 이상으로 확대된다. Overlay 계측 수요는 첨단 공정에서의 정렬 오차(Overlay Error) 허용 범위의 축소에 따른 샘플링 밀도가 높아짐에 따라 증가하는 측면도 있겠으나, 이와 같이 주로 노광 공정 횟수 증가가 Overlay 수요 확대에 기여한다.

AI 수요 확대에 따라

선단 공정 중심 반도체 투자

기술화

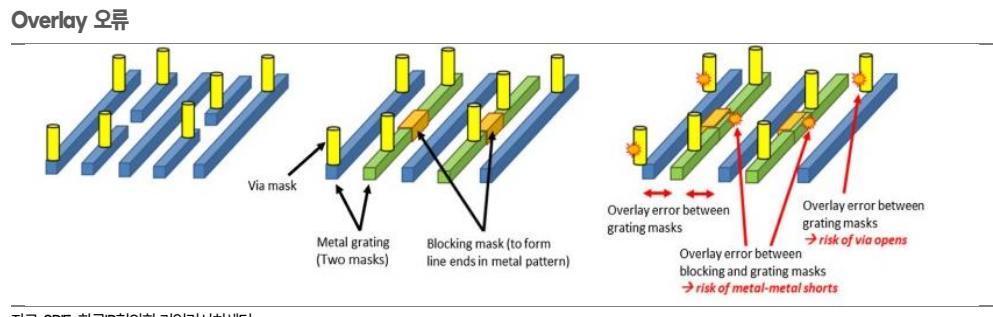
현재 반도체 수요가 AI 중심으로 강세가 나타나면서 선단 공정이 적용되는 반도체 수요가 강하다. 대표적으로 TSMC의 7nm 이하 공정 제품의 매출 비중은 1Q23 51%, 1Q24 65%에서 1Q25 73%까지 확대되었다. DRAM도 업계 1a nm 이하 공정의 비중이 2024년 43%에서 2025년 64%로 확대될 것으로 예상된다. NAND는 200단 이상 비중이 2024년 20.5%에서 2025년 42.3%까지 증가할 전망이다. 선단 제품 수요 대응을 위한 반도체 생산업체의 지속적인 신규 Fab 투자와 선단 공정 전환에 따라 동사의 Overlay 장비의 수요도 동반 성장할 것으로 기대된다. DRAM은 삼성 전자의 P4와 SK하이닉스의 M14, M16 일부 라인 투자가 있다. Micron(미국)은 2027년 하반기 DRAM 양산을 목표로 Idaho ID1 Fab 투자를 진행 중이다. 다만 SK하이닉스의 M15X 설비 투자는 다소 지연될 것으로 예상되어, 10~11월 내 Fab 장비 반입이 시작될 것으로 보인다. NAND는 대부분 신규 CAPA 증가가 부재한 가운데 가동률이 낮은 상황이나 고단화 전환 투자를 진행 중이다. 삼성전자는 시안 Fab을 V8(236단) 전환하는 한편, 화성과 평택 일부 라인도 V8, V9(290단)로 전환 중이다. 신규투자를 진행하는 Kioxia(일본)는 Kitakami Fab2를 9월에 가동할 예정이다.

해외 고객사 비중 증가로

선단 공정 CAPEX 확대에 따른

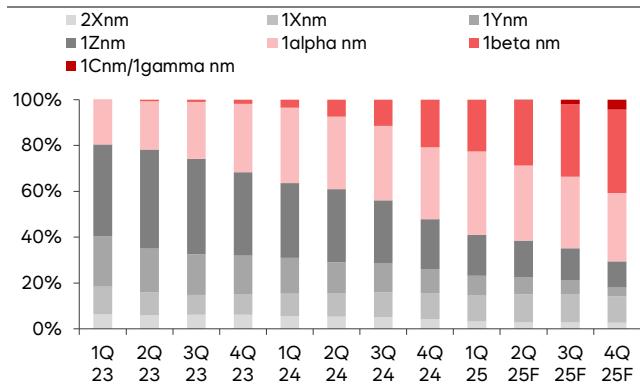
수혜 강화 기대

또한 동사는 국내 고객사 중심에서 해외 고객사로 공급이 다변화되고 있다. 중국 메모리 고객사의 비중이 증가 추세에 있으며 최근에는 일본 NAND 고객사로 웰 테스트가 완료되어 하반기 장비 공급이 기대되고 있다. 이에 따라 과거 대비 선단 공정 CAPEX 확대에 따른 수혜 강도가 강해질 것으로 전망한다.



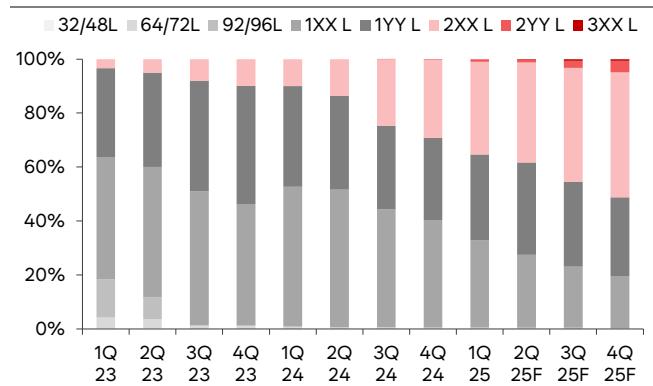
자료: SPIE, 한국IR협의회 기업리서치센터

DRAM Node별 비중



주: x, y, z, a, b, c 등은 DRAM의 미세 공정 세대를 구분하는 명칭. x→y→z→a→b→c 순서로 선풍이 미세화
자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

NAND Node별 비중



주: 32/48L, 64/72L, 1XX 등은 NAND의 적층 단수를 의미. 숫자가 증가할수록 고단화
자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

반도체 후공정 Overlay로 영역 확대 중

IR Overlay 장비로 하이브리드

본딩 후공정 시장 진입 시 점유율 확대 전망

동사는 Overlay 장비의 영역을 기존 전공정에서 후공정으로 확대할 계획이다. IR Overlay 계측 장비는 하이브리드 본딩 공정에서 웨이퍼-웨이퍼(W2W) 또는 다이-웨이퍼(D2W) 간의 정렬 오차(Overlay Error)를 측정하는 장비로, 적외선(IR)을 활용해 불투명한 실리콘 기판을 투과하여 정렬 마크를 감지한다. 하이브리드 본딩은 Cu-Cu 및 유전체 간 동시에 접합 방식으로, 400nm~1μm 피치에서 100nm 미만의 정렬 오차를 요구한다. 이는 기존 TSV 기반 3D 적층(피치 10 μm 이상)에 비해 정밀도가 대폭 강화된 공정이다. TSV 공정은 기시광 기반 계측이 가능했으나, 하이브리드 본딩은 불투명한 실리콘층을 투과해야 하므로 IR 기반 계측이 필수적이다.

동사는 하이브리드 본딩이 이미 적용되고 있는 NAND와 HBM에 하이브리드 본딩 적용 시 장비 공급 확대를 기대하고 있다. HBM4e부터 하이브리드 본딩 적용이 예상되며 NAND는 하이브리드 본딩을 적용함에도 IR Overlay 수요가 크지 않았으나 고단화 진행에 따라 IR Overlay 필요성이 대두되고 있다. 동사는 현재 국내 고객사를 대상으로 IR Overlay 장비 퀄 테스트를 진행 중인 것으로 파악된다. KLA의 점유율이 높은 기존 전공정 Overlay 장비와 달리 상대적으로 신규 시장인 만큼 초기 시장 진입에 따라 동사 점유율 확대가 가능할 것으로 전망한다.

**동사는 HBM 공정 정밀도 향상을
위해 고정밀 Pad Overlay 계측
장비 공급 중**

또한 HBM 공정에서 사용되는 Pad Overlay 계측 장비를 출시하여 고객사에 공급 중이다. Pad Overlay는 TSV 형성 후, 상부 금속층과 TSV 간의 정렬 오차 또는 공정상 위치 정합 편차를 보정하기 위해 설계된다. TSV 공정 이후 TSV 훌에 금속(Cu)을 채우고 CMP 공정을 통해 평탄화가 이루어진 후, 상부 배선층(RDL)과의 연결을 위한 PAD가 형성되는데, 이때 PAD와 TSV 간의 정렬 상태는 전기적 연결의 신뢰성을 좌우하므로 Overlay 계측을 통해 정확히 확인할 필요가 있다. 특히 HBM 스태킹 공정에서는 마이크로 범프와 패드 간 정렬 정확도가 중요하며, 하이브리드 본딩 방식에서는 마이크로 범프 없이 Cu-Cu 간 직접 접합이 이루어지기 때문에 정렬 정밀도가 제품 수율에 직접적인 영향을 미친다. 하이브리드 본딩에서는 마이크로 범프 기반 TSV보다 훨씬 더 높은 정렬 정밀도가 요구되므로, 전통적인 Pad overlay 설계만으로는 한계가 있으며, 나노미터(nm) 수준의 Overlay 제어와 Alignment 보정 기술이 핵심이 된다. 이를 위해 고정밀 Overlay 측정 시스템을 통해 정렬 상태를 정량적으로 평가하고, 필요 시 Linear correction을 포함한 보정 공정이 필수적으로 적용된다.

**웨이퍼 다이의 휘어짐을 측정하기
위한 Warpage 계측 장비도 국내
고객사향으로 공급 중**

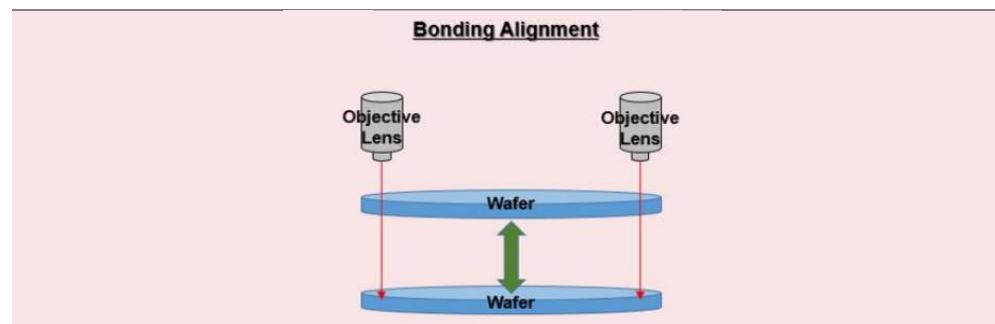
Warpage 계측 장비는 패키징 과정 중 발생할 수 있는 웨이퍼 또는 다이의 뒤틀림(warpage, 훨)을 정밀하게 측정하기 위한 장비이다. Warpage는 미세화된 패키징 공정에서 수율 저하, 접합 불량(bonding failure), 패키지 신뢰성 저하 등의 문제를 유발할 수 있기 때문에, 이를 정확히 계측하고 관리하는 것이 필요하다.

WLP(Wafer Level Packaging) 공정은 패키지 작업을 웨이퍼 단위에서 수행하는 방식으로, 기존 개별 칩 단위의 패키징(FCP, BGA 등)보다 더 얇고 작으며 고성능 패키지를 구현할 수 있다. 하지만 패시베이션, RDL(Redistribution Layer), bump 형성, 백그라운딩 등 다양한 열·기계적 공정이 반복되면서 재료 간 열팽창계수(CTE) 불일치로 인해 Warpage가 발생한다. 이러한 Warpage는 특히 고밀도 인터커넥션이나 Fine-pitch 범프 공정에서 접합 불량의 주요 원인이 되므로, 정밀한 계측을 통한 품질 모니터링과 수율 관리가 필수적이다. 이에 따라 동사는 Warpage 계측 장비를 국내 고객사에 공급하며 관련 시장에 대응하고 있다.

**후공정 장비 매출 증가에 따라
장비 포트폴리오 및 고객사 다변화
기대**

이들 후공정 장비들은 최근 수요가 지속적으로 증가하고 있는 HBM, Advanced Packaging 향이며 전공정 대비 신규 시장으로 동사의 시장 진입이 용이할 것으로 판단된다. 후공정 장비를 통해 기존 전공정 Overlay에 편중되어 있던 장비 포트폴리오 및 고객사 다변화를 기대한다.

하이브리드 본딩 Alignment



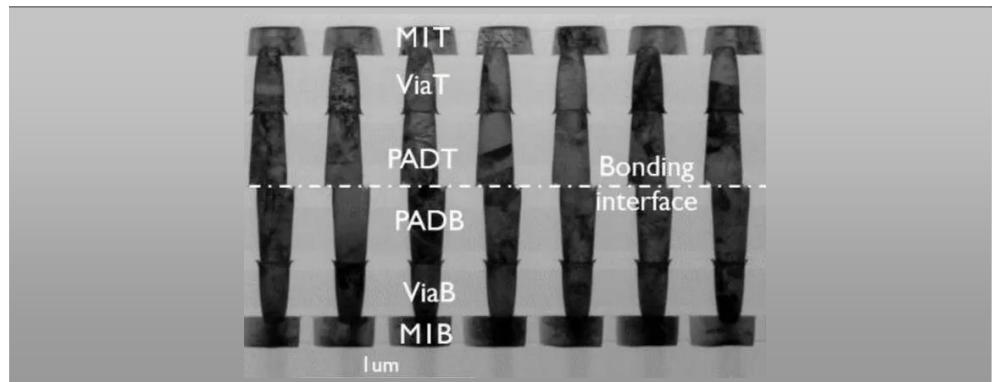
자료: 오로스테크놀로지, 한국IR협의회 기업리서치센터

하이브리드 본딩 적용 어플리케이션

Application	CIS	NAND	DRAM	Logic		Advanced Package
Stacking Device	BSI (Sensor + (Memory + Logic))	3D NAND Cell + Peripheral	3D DRAM Cell + Peripheral	Backside PDN Logic + Bare Si	Sequential CFET Logic + Logic	HBM DRAM () DRAM () + Logic
	W-W Cu Hybrid	W-W Cu Hybrid	W-W Cu Hybrid	W-W Ox Fusion	W-W Ox Fusion	D-W u Bump → Cu Hybrid
	3um →1um	1um →0.5um	1um →0.5um	Sub um (nTSV)	Sub um (nTSV)	40um →25um
Structure						
Status	HVM	R&D~HVM	R&D	R&D	R&D	R&D

자료: Besi, 한국IR협의회 기업리서치센터

하이브리드 본딩에서 400nm 피치 Cu 패드



자료: imec, 한국IR협의회 기업리서치센터

▣ 박막 두께 측정 장비로 전공정 장비 라인업 확대

박막 두께 측정 장비로 전공정

Metrology 영역 확대 시도 중

동사는 박막 두께 측정 장비를 통해 전공정 Metrology 영역 확대를 시도하고 있다. 박막 두께 측정(Film Thickness Measurement)은 반도체 제조 공정에서 증착된 박막(Thin Film)의 두께를 정밀하게 측정하는 과정으로, 소자의 전기적 특성, 식각 균일도, 패턴 정합성 등에 직접적인 영향을 미치기 때문에 공정 제어에 있어 핵심적인 요소이다.

주요 측정 방식으로는 엘립소메트리(Ellipsometry)와 리플렉토메트리(Reflectometry)가 있으며, 두 방식 모두 반사된 빛의 특성을 분석하여 박막 두께를 계측한다. 엘립소메트리는 빛의 반사도뿐만 아니라 편광 상태의 변화를 함께 측정하여 위상 정보를 정밀하게 파악할 수 있어, 수 나노미터 단위의 얇은 박막 측정에 적합하다. 반면, 리플렉토메트리는 반사도만 측정하므로 민감도는 다소 낮지만, 빠른 측정 속도를 바탕으로 상대적으로 두꺼운 박막 측정에 유리하다.

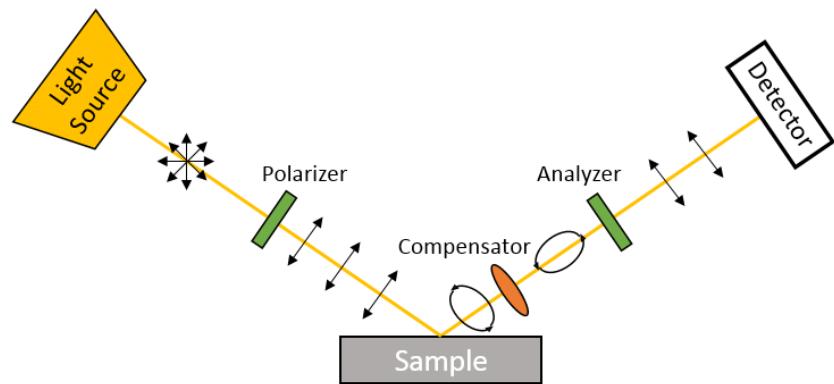
엘립소메트리 장비 출시에 따른

동사의 전공정 장비 라인업 확대

기대

동사는 현재 엘립소메트리 장비를 개발하였으며 하반기 국내 고객사에 퀄을 진행할 예정이다. 박막 두께 측정 장비는 Overlay 장비와 같이 전공정에서 수요가 큰 장비로 동사의 시장 진입은 장비 국산화와 전공정 장비 라인업 확대라는 측면에서 의미가 있으며, 향후 동사의 성장 동력이 될 것으로 전망한다.

엘립소메트리 계측 방식

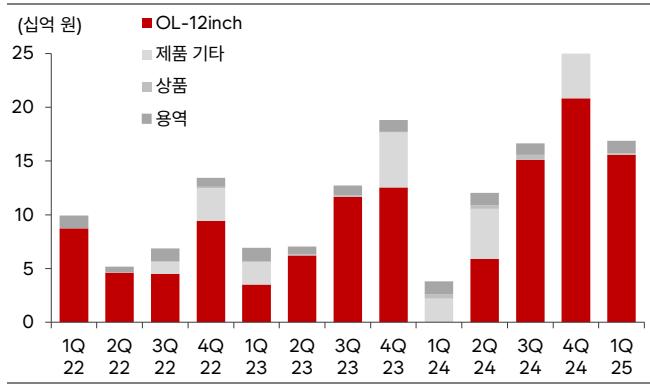


자료: 산업자료, 한국IR협의회 기업리서치센터

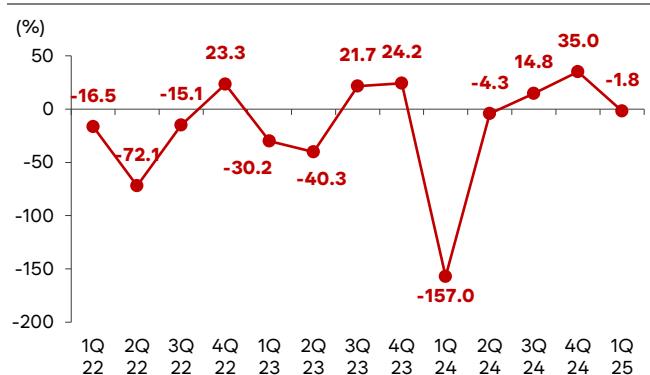

실적 추이 및 전망
1 전공정 Overlay 장비 외 공급 개시

2024년 매출액 614억 원(+34.9% YoY), 영업이익 61억 원(+156.7% YoY)을 기록

2024년 동사는 매출액 614억 원(+34.9% YoY), 영업이익 61억 원(+156.7% YoY)을 기록하였다. 반도체 고객사들의 CAPEX 증가폭이 크지 않았음에도 견조한 성장을 보였는데, 전반적인 실적 성장을 견인한 것은 후공정 장비 매출 증가이다. 구체적으로 후공정 장비인 Pad Overlay, Warpage 계측 장비 공급이 국내 고객사 향으로 개시되었고, IR Overlay도 퀄을 진행하였다. 또한, 신규 Overlay 장비로의 국내 고객사 전환 수요가 발생하였고, 4Q24에는 중화권 고객 수요 확대에 따른 하반기 매출 기여도가 커졌다. 수익성 측면에서는 매출액 규모 증가, 고부가 장비 중심의 제품 믹스 개선, 중국향 매출 비중 증가로 전년 대비 4.7%p 개선된 영업이익률 9.9%를 기록하였다.

오로스테크놀로지 부문별 실적 추이


자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

오로스테크놀로지 분기별 영업이익률 추이


자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

2 고객사 및 장비 다변화로 매출 성장 전망

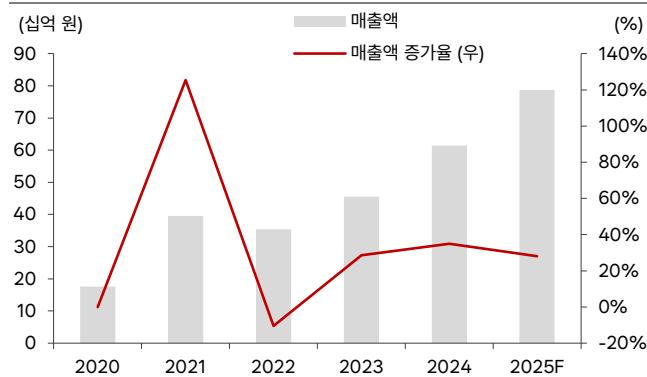
2025년 매출액 787억 원(+28.1% YoY), 영업이익 103억 원(+69.1% YoY) 전망

2025년 1분기 실적은 매출액 169억 원(+342.6% YoY, -41.7% QoQ), 영업손실 3억 원(적자지속 YoY, 적자전환 QoQ)을 기록하였다. 계절적 비수기임에도 불구하고 장비 라인업 확대와 전년 동기 매출 인식 지연에 따른 낮은 기저 효과로 전년 대비 큰 폭의 외형 성장을 기록하였다. 특히, 2024년 말 소폭 하락했던 ASP가 재상승하며 긍정적인 영향을 끼쳤다. 반면, 영업이익은 3억 원 적자를 기록하며 전년 동기 적자 폭은 축소하였으나, 전 분기 흑자에서 적자로 전환되었다. 이는 해외 법인 설립에 따른 일회성 비용과 고마진 중국향 매출 부재, 그리고 신규 일본 고객시장 데모 장비 납품으로 인한 원가율 상승에 따른 마진율이 훼손 영향이 있었다.

2025년 연간 실적은 매출액 787억 원(+28.1% YoY), 영업이익 103억 원(+69.1% YoY)을 전망한다. 상반기는 계절적 비수기 영향으로 다소 저조하나, 하반기로 갈수록 고객사 CAPEX 확대와 제품 포트폴리오 다변화로 실적이 개선될 것으로 전망한다. 특히 후공정 오버레이 장비 비중 및 고마진 중국향 매출 증가, 신규 고객사 발주로 ASP 상승 및 수익성 향상이 지속된다. 하반기 박막 두께 계측 퀄 장비 출하와 일본 고객사 향 양산 장비 공급으로 매출이 증가하며 계절적 변동도 전년 대비 완화될 것으로 보인다. 고객사 다변화는 기존 국내 고객사 중심에서 일본, 중국으로 확장 중이며, 또 다른 국내 고객사는 전공정 비메모리 중심 퀄을 진행하며 메모리로 적용 확대를 꾀하고 있다. 3D 적층 트렌드에 따

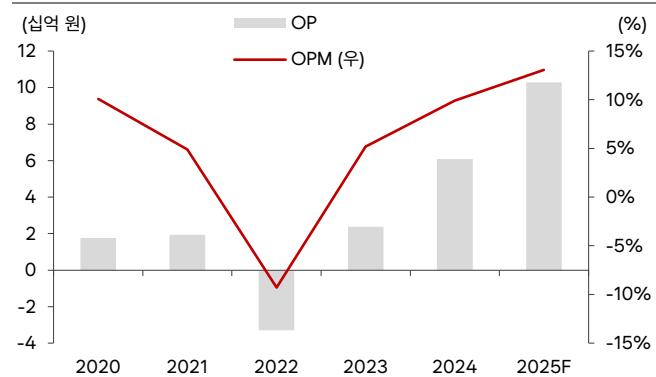
라 OSAT, 파운드리, 8인치 웨이퍼 업체로 시장 확장이 기대되며, 하이브리드 본딩 도입과 함께 IR 오버레이와 박막 두께 계측 장비가 중장기 성장 동력으로 전망된다. 다만, 제품 믹스 다변화 초기 비용으로 이익 변동성이 확대될 가능성 있으나 하반기 해외 출하와 선단 공정 장비 확대를 통해 매출과 수익성 성장세가 지속될 것으로 보인다. 따라서 영업이익률은 전년 대비 3.2%p 개선된 13.1%를 전망한다.

오로스테크놀로지 매출액 및 매출액 증가율 추이



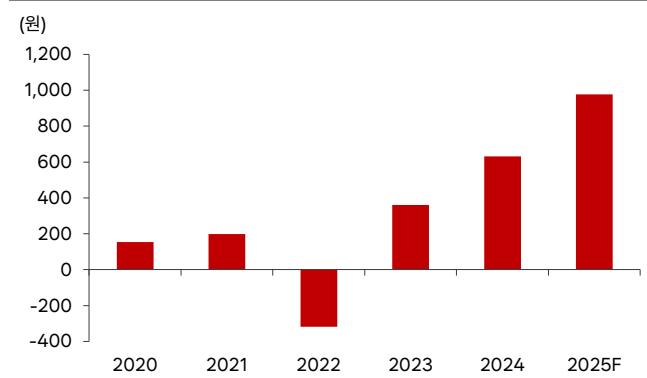
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

오로스테크놀로지 영업이익 및 영업이익률 추이



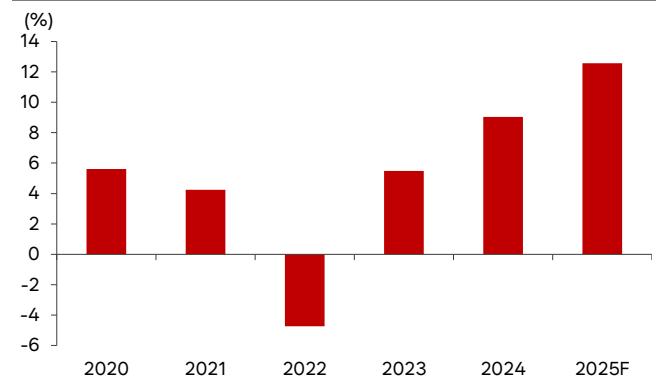
자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

오로스테크놀로지 EPS 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

오로스테크놀로지 ROE 추이



자료: WiseFN, 한국IR협의회 기업리서치센터

오로스테크놀로지 부문별 실적

(단위: 십억원)

	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2022	2023	2024	2025F
매출액	9.9	5.2	6.9	13.4	6.9	7.1	12.7	18.8	3.8	12.0	16.6	28.9	16.9	35.4	45.5	61.4	78.7
OL-12inch	8.7	4.6	4.5	9.4	3.5	6.2	11.7	12.6	-	5.9	15.1	20.8	15.6	27.3	34.0	41.8	50.9
제품 기타	-	-	1.1	3.1	2.1	-	-	5.1	2.2	4.7	-	6.5	-	4.2	7.2	13.3	21.0
상품	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.4	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.3	1.5	1.4
용역	1.2	0.5	1.2	0.8	1.3	0.7	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	1.3	1.2	3.7	4.1	4.7	5.3
영업이익	-1.6	-3.7	-1.0	3.1	-2.1	-2.8	2.8	4.5	-6.0	-0.5	2.5	10.1	-0.3	-3.3	2.4	6.1	10.3
지배주주순이익	-1.3	-3.4	-0.4	2.1	-1.9	-2.2	3.3	4.1	-5.3	-0.3	2.8	8.8	-0.4	-3.0	3.4	5.9	9.2
Margin(%)																	
영업이익률	-16.5	-72.1	-15.1	23.3	-30.2	-40.3	21.7	24.2	-157.0	-4.3	14.8	35.0	-1.8	-9.3	5.2	9.9	13.1
지배주주순이익률	-13.5	-65.0	-5.2	15.6	-26.9	-31.4	26.0	22.0	-140.2	-28	17.0	30.3	-2.2	-8.4	7.4	9.6	11.6
YoYGrowth(%)																	
매출액	-	-	80.0	146.0	-30.2	36.2	85.7	40.1	-45.0	70.4	30.8	53.8	342.6	-10.5	28.6	34.9	28.1
OL-12inch	-	-	-	-	-59.8	35.1	159.3	33.1	-100	-5.1	29.4	65.9	-	-24.0	24.5	23.2	21.6
제품 기타	-	-	-	-	-	-	-100	67.2	4.8	-	-	27.4	-100	397.0	72.5	85.4	57.4
상품	-	-	-	-	25.0	118.2	131.5	-38.4	2,427	239.6	276.8	391.3	-63.1	103.7	37.4	396.7	-4.9
용역	-	-	-	-	10.3	39.1	-20.3	31.0	-4.9	53.9	14.6	15.6	-6.4	39.2	9.4	15.9	13.4
영업이익	-	-	적지	흑전	적지	적지	흑전	45.6	적지	적지	-10.8	122.8	적지	적전	흑전	156.7	69.1
지배주주순이익	-	-	적지	흑전	적지	적지	흑전	97.7	적지	적지	-14.5	111.6	적지	적전	흑전	74.8	54.9
QoQGrowth(%)																	
매출액	82.1	-47.9	32.3	95.9	-48.4	1.8	80.4	47.8	-79.7	215.4	38.4	73.8	-41.7				
OL-12inch	-	-47.4	-2.2	109.8	-62.7	76.5	87.8	7.6	-100	-	155.9	38.0	-25.2				
제품 기타	-	-	-	171.1	-31.1	-100	-	-	-56.9	111.4	-100	-	-	-100			
상품	-	266.7	22.7	107.4	-86.6	540	30.2	-44.8	449.3	-14.0	44.5	-28.0	-	-58.7			
용역	-	-54.3	118.8	-29.8	57.2	-42.4	25.4	15.4	14.2	-6.8	-6.6	16.4	-	-7.6			
영업이익	적지	적지	적지	흑전	적전	적지	흑전	65.0	적전	적지	흑전	311.9	적전				
지배주주순이익	적지	적지	적지	흑전	적전	적지	흑전	24.9	적전	적지	흑전	209.1	적전				

자료: Quantwise, 한국IR협의회 기업리서치센터



Valuation

■ 2025F PBR 2.4x

오로스테크놀로지의 2025F

PBR은 2.4x배, 글로벌 Peer 업체의 2025F 평균 PBR은 15.7x 수준

동사의 현주가는 2025F PBR 2.4x로 Historical PBR Band(1.3x~5.6x) 중하단에 위치해 있다. 동사의 Peer 업체로는 MI 장비 업체인 KLA(미국)와 Onto Innovation(미국)을 선정하였다. Peer 업체의 2025F 평균 PBR은 15.7x 수준이며 KLA의 PBR은 29.1x인 반면 Onto Innovation은 동사와 유사한 2.3x 수준이다. KLA의 경우 MI 시장 글로벌 1위 기업으로 우수한 재무 성과, 시장 지배력, AI 수혜 등의 이유로 높은 Valuation을 부여받고 있다. Onto Innovation의 경우 Advanced Packaging에서의 강점으로 주가 상승을 보였으나 정체된 매출액 성장과 높은 Valuation 부담으로 반도체 수요 단기 조정에 따라 주가가 크게 하락한 상태이다. Onto Innovation과 오로스테크놀로지의 2025F ROE는 각각 12.6%, 12.4%로 유사하다. 참고로 KLA의 2025F ROE는 109.1%이다.

2023년말~2024년초 AI 반도체

**시장 확대에 따른 동사 장비 수혜
기대감으로 상승했던 주가는 현재
Band 중하단에 위치**

오로스테크놀로지는 국내 유일의 Overlay 계측 장비 업체로 높은 Valuation을 부여받으며 상장되었다. 하지만 이후 2022년 반도체 업황 악화로 인한 실적 둔화로 주가는 PBR Band 하단까지 하락하였고, 이후 2023년말~2024년초 AI 반도체 시장 확대에 따라 고정밀 측정 장비 수요 기대감이 확대되며 주가는 Band 상단까지 상승하였다. 이후, 2024년 하반기부터 반도체 업황 둔화 우려감이 재차 확대되며 현재 주가는 Band 중하단까지 하락한 상태이다.

Overlay 중심에서 IR

**Overlay 박막 측정 장비 등으로
제품 다변화하며 Valuation
확대를 기대**

동사는 주력 장비인 전공정 Overlay를 해외 고객사로 다변화하는 한편, IR Overlay, 박막 두께 측정 장비 등으로 장비 다변화 또한 시도하고 있다. 특히 박막 두께 측정 장비는 전공정에서 수요가 큰 장비로 동사 시장 진입 시 국산화와 전공정 장비 라인업 확대의 의미가 있고 IR Overlay는 하이브리드 본딩에 사용되는 장비로 향후 HBM 수혜가 기대되는 만큼 시장 안착 시 동사 Valuation 확대에 기여할 것으로 판단한다.

동종 업종 밸류에이션

기업명	종가 (원, 달러)	시가총액 (십억원, 백만달러)	매출액(십억원, 백만달러)			PER(배)			PBR(배)		
			2023	2024	2025F	2023	2024	2025F	2023	2024	2025F
코스피	3,188	2,541,309	3,517,716	3,721,719	2,993,961	-	-	11.7	-	-	1.0
코스닥	821	426,536	330,041	334,267	112,350	-	-	28.4	-	-	2.7
오로스테크놀로지	19,950	187	46	61	79	81.1	25.5	20.4	4.4	2.2	2.4
KLA Corporation(미국)	937	123,133	9,671	10,847	12,059	20.1	40.7	28.7	22.7	32.9	29.1
Onto Innovation(미국)	99	4,744	816	987	1,001	62.2	42.0	18.8	4.3	4.4	2.3
동종업종 평균						41.2	41.3	23.8	13.5	18.6	15.7

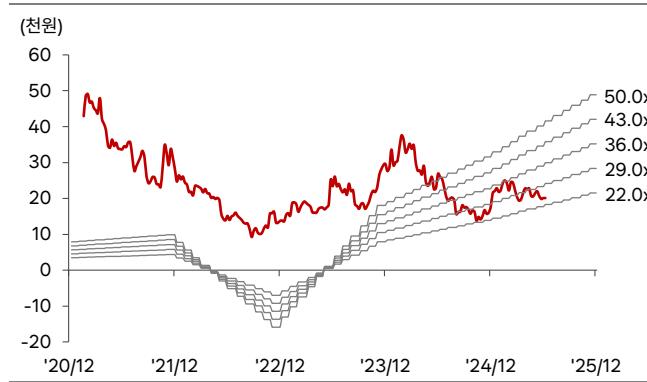
주: 1) 2025년 07월 18일 종가 기준. 동종그룹 25F는 시장 컨센서스 사용, 2) Onto Innovation의 2025F PBR은 2025F 자본 총계 사용

자료: Quantwise, Refinitiv, 한국IR협의회 기업리서치센터

Metrology & Inspection 업체 상대 주가 추이



오로스테크놀로지 PER Band



오로스테크놀로지 PBR Band



 **리스크 요인****1 높은 단일 장비 매출 비중과 고객사 CAPEX****고객사-장비 다변화로 CAPEX****실적 변동성 완화 예상**

동사의 주요 리스크는 전공정 Overlay 장비에 대한 높은 의존도와 고객사 CAPEX 변화에 따른 실적 변동성이다. 반도체 장비 업체의 특성상 동사의 실적은 반도체 생산업체의 CAPEX 변화에 영향을 받으며, 특히 동사는 국내 메모리 업체를 주요 고객으로 두고 있어 메모리 업황에 민감하다. 2025년 국내 DRAM CAPEX는 AI 수요에 따른 HBM 및 선단 공정 투자 확대로 전년 대비 15.6% 증가가 예상되는 반면, NAND는 수요 부진으로 CAPEX가 8.1% 감소할 전망이다. 이에 따라 국내 메모리 CAPEX는 전년 대비 6.5% 증가할 것으로 보인다.

동사의 2025년 매출액은 전년 대비 28.1% 증가할 것으로 추정하는데, 이는 고객사 CAPEX 성장률을 상회하는 수준이다. 그 이유는 일본 고객사향 전공정 Overlay 양산 장비 공급, 고마진의 중국향 매출 확대, 후공정 Overlay 장비 납품 확대, 박막 두께 계측 장비 출하 등 장비 및 고객사 다변화에 따른 제품 믹스 개선 효과가 기대되기 때문이다. 따라서 고객사 및 장비 다변화로 과거 대비 고객사 CAPEX 변동에 따른 변동성도 점차 완화될 것으로 기대된다.

포괄손익계산서

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
매출액	395	354	455	614	787
증가율(%)	125.4	-10.5	28.6	34.9	28.1
매출원가	157	131	151	252	352
매출원가율(%)	39.7	37.0	33.2	41.0	44.7
매출총이익	238	223	304	362	434
매출이익률(%)	60.2	63.1	66.8	59.0	55.2
판매관리비	219	256	280	301	331
판관비율(%)	55.4	72.3	61.5	49.0	42.1
EBITDA	38	-5	57	102	168
EBITDA 이익률(%)	9.6	-1.4	12.5	16.6	21.3
증가율(%)	38.2	적전	흑전	78.5	64.9
영업이익	19	-33	24	61	103
영업이익률(%)	4.9	-9.3	5.2	9.9	13.1
증가율(%)	9.7	적전	흑전	156.7	69.1
영업외손익	6	3	9	12	10
금융수익	9	18	23	15	15
금융비용	3	13	17	7	9
기타영업외손익	-0	-1	3	4	4
종속/관계기업관련손익	0	0	0	0	0
세전계속사업이익	25	-30	33	73	113
증가율(%)	82.1	적전	흑전	121.0	55.7
법인세비용	7	0	-1	14	21
계속사업이익	18	-30	34	59	92
중단사업이익	0	0	0	0	0
당기순이익	18	-30	34	59	92
당기순이익률(%)	4.5	-8.4	7.4	9.6	11.6
증가율(%)	58.5	적전	흑전	74.8	54.9
지배주주지분 순이익	18	-30	34	59	92

재무상태표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
유동자산	499	418	381	527	658
현금성자산	216	194	149	141	277
단기투자자산	164	10	0	0	0
매출채권	3	55	15	100	61
재고자산	104	152	207	278	310
기타유동자산	12	7	10	7	9
비유동자산	248	279	361	417	414
유형자산	134	161	173	226	223
무형자산	8	11	14	25	13
투자자산	61	57	57	43	55
기타비유동자산	45	50	117	123	123
자산총계	747	697	742	944	1,072
유동부채	81	55	68	205	230
단기차입금	20	0	0	102	102
매입채무	13	18	12	19	20
기타유동부채	48	37	56	84	108
비유동부채	22	32	50	57	70
사채	0	0	0	0	0
장기차입금	0	0	0	0	0
기타비유동부채	22	32	50	57	70
부채총계	103	86	118	262	299
지배주주지분	645	611	624	682	773
자본금	47	47	47	47	47
자본잉여금	399	399	399	399	399
자본조정 등	21	25	11	5	5
기타포괄이익누계액	0	0	-1	3	3
이익잉여금	177	139	167	227	319
자본총계	645	611	624	682	773

현금흐름표

(억원)	2021	2022	2023	2024	2025F
영업활동으로인한현금흐름	94	-92	74	-53	196
당기순이익	18	-30	34	59	92
유형자산 상각비	17	25	30	34	53
무형자산 상각비	2	3	4	7	12
외환손익	0	1	0	0	0
운전자본의감소(증가)	14	-117	-8	-182	39
기타	43	26	14	29	0
투자활동으로인한현금흐름	-305	114	-98	-43	-62
투자자산의 감소(증가)	0	0	0	0	-12
유형자산의 감소	0	1	0	0	0
유형자산의 증가(CAPEX)	-103	-36	-40	-50	-50
기타	-202	149	-58	7	0
재무활동으로인한현금흐름	395	-44	-22	84	3
차입금의 증가(감소)	0	-20	0	102	3
사채의증가(감소)	0	0	0	0	0
자본의 증가	398	0	0	0	0
배당금	0	0	0	0	0
기타	-3	-24	-22	-18	0
기타현금흐름	0	0	0	3	0
현금의증가(감소)	185	-22	-45	-8	137
기초현금	31	216	194	149	141
기말현금	216	194	149	141	278

주요투자지표

	2021	2022	2023	2024	2025F
P/E(배)	158.5	N/A	81.1	25.5	20.4
P/B(배)	4.6	2.0	4.4	2.2	2.4
P/S(배)	7.2	3.5	6.0	2.5	2.4
EV/EBITDA(배)	68.5	N/A	45.7	14.6	10.2
배당수익률(%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EPS(원)	198	-318	361	631	977
BPS(원)	6,882	6,520	6,658	7,279	8,256
SPS(원)	4,358	3,779	4,861	6,557	8,399
DPS(원)	0	0	0	0	0
수익성(%)					
ROE	4.2	-4.7	5.5	9.0	12.6
ROA	3.5	-4.1	4.7	7.0	9.1
ROIC	6.5	-13.0	5.1	10.1	15.6
안정성(%)					
유동비율	617.1	764.1	558.0	257.0	286.3
부채비율	15.9	14.1	19.0	38.5	38.7
순차입금비율	-53.2	-31.1	-21.3	-2.3	-19.3
이자보상배율	13.4	-44.5	24.3	23.4	22.2
활동성(%)					
총자산회전율	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8
매출채권회전율	27.2	12.2	13.0	10.7	9.8
재고자산회전율	3.9	2.8	2.5	2.5	2.7

최근 3개월간 한국거래소 시장경보제도 지정 여부

시장경보제도란?

한국거래소 시장감시위원회는 투기적이거나 불공정거래 개연성이 있는 종목 또는 주가가 비정상적으로 급등한 종목에 대해 투자자주의 환기 등을 통해 불공정거래를 사전에 예방하기 위한 제도를 시행하고 있습니다. 시장경보제도는 「투자주의종목 투자경고종목 투자위험종목」의 단계를 거쳐 이루어지게 됩니다.

※관련근거: 시장감시규정 제5조의2, 제5조의3 및 시장감시규정 시행세칙 제3조~제3조의7

종목명	투자주의종목	투자경고종목	투자위험종목
오로스테크놀로지	X	X	X

발간 History

발간일	제목
2025.07.22	오로스테크놀로지-고객사장비 다변화 시도 종
2022.11.15	오로스테크놀로지-반도체 미세화 및 각자도생 수혜주

Compliance notice

본 보고서는 한국거래소, 한국예탁결제원과 한국증권금융이 공동으로 출연한 한국IR협의회 산하 독립 (리서치) 조직인 기업리서치센터가 작성한 기업분석 보고서입니다. 본 자료는 투자자들에게 국내 상장기업에 대한 양질의 투자정보 제공 및 건전한 투자문화 정착을 위해 무상으로 작성되었습니다.

- 당사 리서치센터는 본 자료를 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트는 자료작성일 현재 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다.
- 본 자료를 작성한 애널리스트와 그 배우자 등 관계자는 자료 작성일 현재 조사분석 대상법인의 금융투자상품 및 권리를 보유하고 있지 않습니다.
- 본 자료는 중소형 기업 소개를 위해 작성되었으며, 매수 및 매도 추천 의견은 포함하고 있지 않습니다.
- 본 자료에 게재된 내용은 애널리스트의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실하게 작성되었음을 확인합니다.
- 본 자료는 투자자들의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 배포되는 자료입니다. 본 자료에 수록된 내용은 자료제공일 현재 시점의 당사 리서치센터의 추정치로서 오차가 발생할 수 있으며 정확성이나 완벽성을 보장하지 않습니다.
- 본 조사자료는 투자 참고 자료로만 활용하시기 바라며, 어떠한 경우에도 투자자의 투자 결과에 대한 법적 책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
- 본 조사자료의 저작재산권은 당사에 있으므로, 당사의 허락 없이 무단 복제 및 배포할 수 없습니다.
- 본 자료는 텔레그램에서 "한국IR협의회(https://t.me/kirsofficial)" 채널을 추가하시어 보고서 발간 소식을 안내받으실 수 있습니다.
- 한국IR협의회가 운영하는 유튜브 채널 'IRTV'에서 1) 애널리스트가 직접 취재한 기업탐방으로 CEO인터뷰 등이 있는 '小中한탐방'과 2) 기업보고서 심층해설방송인 '小中한 리포트 가치보기'를 보실 수 있습니다.